

レーザースルーホールフィリング用硫酸銅めっき添加剤

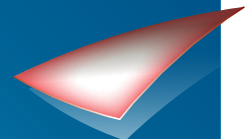
トップルチナLTF

Additives for Acid Copper Plating to Laser Through-hole Filling

TOP LUCINA LTF

- ▶ 低膜厚でのスルーホールフィリングを実現
- ▶ 低膜厚化により配線の微細化に対応
- ▶ コア基板形成における工程簡略化が可能
- ▶ 全ての添加剤成分の定量分析が可能

- Realize through-hole filling by thin thickness
- Applicable to micro-patterning by thin thickness
- Can reduce treatment steps by forming core substrates
- Quantitative analysis is possible for all additives



低膜厚でのスルーホールフィリングを実現

Realize through-hole filling by thin thickness

硫酸銅五水和物
CuSO₄·5H₂O

230g/L

硫酸
H₂SO₄

70g/L

塩化物イオン
Cl⁻

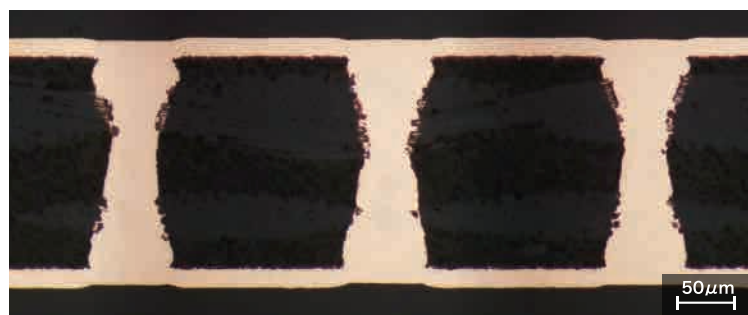
30mg/L

電流密度
Current density

1.0A/dm²

めっき膜厚
Film thickness

15μm

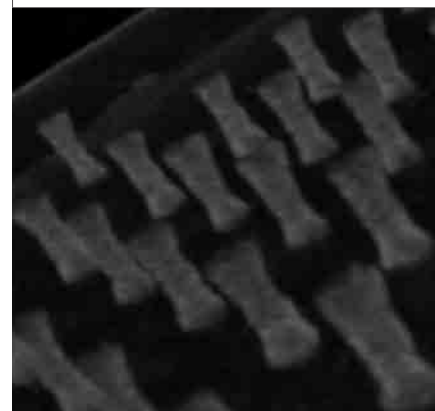


穴径 80μm
板厚 200μm
Hole diameter 80μm
Board thickness 200μm

透過X線像 X-ray transmission image

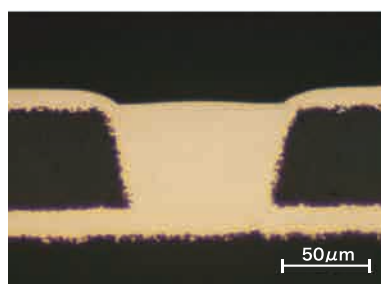


X線-CT像 X-ray CT image



ビアフィリングめっきも可能

Also, can be used for via filling

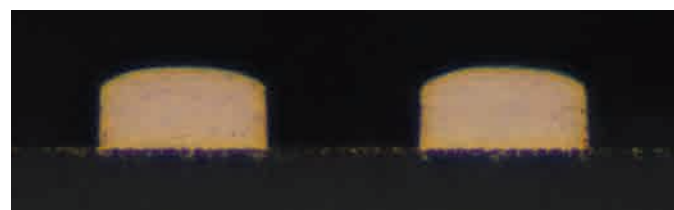


穴径 110μm
深さ 60μm
Via hole diameter 110μm
Via hole depth 60μm

めっき膜厚: 10μm
Plating thickness: 10μm

パターンめっき断面

Cross-section image of pattern plating



L/S=30/30μm